

PRESS RELEASE (2024/04/17)

九州大学×TSMC 包括連携の覚書を締結 ～半導体分野の研究および人材育成における協力関係をより強固に！～

このたび、九州大学は、世界的半導体メーカーである Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) との間で、半導体分野の研究および人材育成における協力関係を発展させることを目的に、包括的な連携の覚書を締結いたしました。

TSMC とはこれまでも、本学教員とのワークショップ等を通じた交流をしてきましたが、今回の連携により、より一層両者間の協力関係が強固になることが期待されます。すでに、本学における TSMC 技術者の講義や、TSMC サマーインターンシップ 2024 (開催場所:台湾) の募集等、具体的な取組も開始されています。

本連携を通じて、九州大学は、半導体分野の研究を加速させるとともに、半導体人材の育成という社会的課題の解決に向けた取組をより一層推進してまいります。



4月12日に行われた、JASMの技術者による大学院講義

【概要】

1. 覚書を締結した日付
令和6年4月1日

2. 覚書の名称
「TSMCと国立大学法人九州大学との覚書」

3. 連携の趣旨

両者間において半導体分野の研究および人材育成における協力関係を発展させること

4. 連携の内容

- ・本学学生および指導教員に対する研究奨励金
- ・本学の講座における講義の提供
- ・本学学生へのインターンシップの提供
- ・両者間の共同開発プロジェクトの締結及びワークショップの実施

5. 直近の取組

- ・4月12日から、TSMCとその日本における子会社である Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 株式会社、TSMC デザインテクノロジージャパン株式会社、TSMC ジャパン 3DIC 研究開発センター株式会社の技術者・研究者による大学院講義(8コマ、1単位)を九大で開講。これは九州域内の8つの大学にオンラインで同時公開した。

・連携の内容にある、「インターンシップの提供」についても、すでに本学で募集を開始している。